

2026 年 9 月 11 日

各位

会 社 名 株式会社 北 川 鉄 工 所
 代表者名 代表取締役社長執行役員 岡野 帝男
 (コード : 6317 東証スタンダード)
 問合せ先 常務執行役員経営管理本部長 北川 和紀
 (T E L : 0847-45-4560)

2027 年 3 月期第 2 四半期（中間期）及び連結業績予想の修正 並びに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2026 年 5 月 13 日に公表した 2027 年 3 月期（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）の第 2 四半期（中間期）及び通期連結業績予想、並びに配当予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 連結業績予想の修正

(1) 2027 年 3 月期第 2 四半期（中間期）連結業績予想

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A）	31,600	1,500	1,600	1,000	106.29
今回修正予想（B）	34,000	2,600	2,700	2,100	223.21
増減額（B－A）	2,400	1,100	1,100	1,100	
増減率（％）	7.6	73.3	68.8	110.0	
（ご参考）前期実績 2026 年 3 月期中間期	29,083	1,373	1,331	2,355	254.88

(2) 2027 年 3 月期通期連結業績予想

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A）	62,500	3,000	3,000	2,000	211.70
今回修正予想（B）	65,700	4,500	4,600	3,400	359.89
増減額（B－A）	3,200	1,500	1,600	1,400	
増減率（％）	5.1	50.0	53.3	70.0	
（ご参考）前期実績 2026 年 3 月期	58,415	2,688	2,545	3,128	338.25

(3) 連結業績予想修正の理由

売上高は、産業機械事業における延期となっていた荷役機械の上期での売上計上及び計画に織込まれていなかった立体駐車場の大型案件の売上計上を主因として、前回発表予想を上回る見込みとなりました。また、工作機器事業における市況回復及び半導体関連事業におけるハードディスク関連製品・消耗品の販売増加も増収増益に寄与する見込みです。金属素形材事業では、メキシコ子会社にて自動車向け部品の計画未達による減益を見込むものの、産業機械事業を中心とする増益がこれを上回るため、各段階利益は前回発表予想を上回る見込みとなりました。

2. 配当予想の修正

(1) 第2四半期配当予想及び期末配当予想

基準日	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回発表予想	円 銭	円 銭	円 銭
	32.00	32.00	64.00
今回修正予想	円 銭	円 銭	円 銭
	50.00	60.00	110.00
(ご参考)前期実績 2026年3月期	35.00	67.00	102.00

(2) 配当予想の修正の理由

当社は、株主還元につきましては、2025年4月18日公表の「配当方針の変更に関するお知らせ」に記載のとおり、当期純利益を基準に段階的な配当を行うことを基本方針としております。当社グループの業績が当初計画を上回って推移していることを踏まえて、通期業績予想を見直した結果、前回予想を上回る見込みとなったため、前回予想の年間配当64円から年間配当110円に修正いたします。

(参考)

セグメント別通期連結売上高及び営業利益の見通し

・売上高

(単位：百万円)

	前回予想	今回予想	増減
キタガワ グローバル ハンド カンパニー (工作機器事業)	10,800	11,300	500
キタガワ サン テック カンパニー (産業機械事業)	21,800	23,400	1,600
キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー (金属素形材事業)	25,800	25,900	100
キタガワ グレステック (半導体関連事業)	2,600	3,200	600
その他	1,500	1,900	400
合計	62,500	65,700	3,200

・営業利益

(単位：百万円)

	前回予想	今回予想	増減
キタガワ グローバル ハンド カンパニー (工作機器事業)	540	910	370
キタガワ サン テック カンパニー (産業機械事業)	1,970	2,930	960
キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー (金属素形材事業)	1,100	930	△170
キタガワ グレステック (半導体関連事業)	300	570	270
その他	220	220	0
全社費用	△1,130	△1,060	70
合計	3,000	4,500	1,500

(注) 本資料に記載の予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

以 上